

Восьма Алуштинська у Пущі-Водиці (про конференцію «Пакувальна індустрія»)

Кожного разу, коли сідаю за письмовий стіл, щоб згадати та занотувати спогади про чергову науково-практичну конференцію в Алушті, перегортаю журнал зі звітом про попередню. Так було і цього разу. Коли прочитав, моєму здивуванню не було меж. Передостанній розділ того звіту називався «Історія конференції в Алушті». В ньому підводилися підсумки про всі сім конференцій: про програмний комітет та його роботу; кількість доповідей, круглих столів; про доповідачів та учасників; спонсорів та організаторів. Наприкінці звіту було написано: «В анкетах майже всі учасники ... бажали повернутися на конференцію до Алушти через рік».

Але сталося те, що сталося. В травні 2014 р. організатори не змогли провести конференцію в Алушті через відомі всім події. VIII науково-практична конференція «Пакувальна індустрія» відбулася 24–25 вересня 2014 р. у затишному куточку Пущі-Водиці під Києвом, а її учасники згодилися залишити в назві конференції слово «Алуштинська».

На останньому слайді доповіді проф. Валентина Шерстюка можна було прочитати: «Якщо I–VII конференції були Алуштинськими, а VIII є Алуштинською у Пущі-Водиці, то якщо не десята, то n-а Алуштинська конференція «Пакувальна індустрія» таки відбудеться в Криму, в Алушті».

До конференції

Програмний та організаційний комітет конференції «Пакувальна індустрія» почали працювати одразу після повернення з Алушти у червні 2013 р. Спочатку були проаналізовані анкети учасників конференції, потім відбулась жвава дискусія членів програмного комітету щодо тематики наступної восьмої конференції. Пригадую пропозиції Геннадія Рябцева та Валерія Шредера, які пропонували зосередити увагу конференції на інноваціях у пакувальній індустрії. А Олександр Гавва доречно запропонував виступити на конференції представникам компаній, особливо українським, та розповісти про практику впровадження інноваційних розробок у виробництво.

У результаті домовились про тематику, яку відобразили як у назві самої конференції, так і її засідань. VIII науково-практична конференція отримала назву — «Пакувальна індустрія (ринок, інновації, бізнес-практики)», пленарне засідання — «Упаковка: тренди, тенденції, прогнози», секційні — «Інновації в пакувальній індустрії», «Сучасні технології та бізнес-практики в упаковці» та круглий стіл — «Упаковка. Як вибрати з урахуванням пріоритетів ринку?» Другу проблему вирішував організаційний комітет. Треба було обрати місце проведення конференції. Зрозуміло було одне — це має бути десь у передмісті Києва. Об'їхали та

переглянули з десяток готелів та пансіонатів у Вишгороді, Бучі, Ірпені, поки не зупинилися на готельному комплексі «Дніпро-Пуща», що у Пущі-Водиці. До речі, і не прогадали. Визначили і термін проведення конференції. Враховуючи події, що відбуваються на сході України, обрали два дні вересня, щоб не надовго відривати учасників від їхньої роботи. На сайті конференції була розміщена детальна інформація про участь у конференції, аспекти її організації та проведення. Майже щодня він поповнювався новинами про учасників, доповідачів, спонсорів.

Генеральним спонсором конференції як і в минулі роки стала компанія «Укрпластик». Спонсорами виступили компанії «Дюпон Україна», DOW Europe GmbH, «Деметра Одіс», Markets Consulting Group. Були встановлені контакти з інформаційним партнером конференції часописом «Технології та інновації».

За два тижні до початку конференції всі учасники отримали запрошення з програмою конференції.

На конференції

Пленарне засідання увібрало в свою програму доповіді про загальний стан та перспективи впровадження інноваційних технологій у виробництво пакувальних матеріалів та упаковки, пакувального обладнання та пакованої продукції.





Шість доповідей пленарного засідання захопили увагу учасників конференції та викликали жваву дискусію. У доповіді к.х.н. **Валерія Кривошея** було відмічено, що незважаючи на всю демократичність такого явища, як упаковка, саме її стан та якість найтіснішим чином пов'язані з виробництвом продукції, особливо харчової, та визначають якість життя мешканців країни. Враховуючи, що упаковка для України є стратегічним продуктом, доповідач відмічає потужне зростання її виробництва та використання в Україні, особливо за останні 10 років. А детальний аналіз стану розвитку всіх секторів пакувальної індустрії України дав змогу уявити загальну картину цієї галузі. Поряд із вкладанням коштів вітчизняних та закордонних інвесторів в інноваційні проекти українських підприємств важливе значення відіграє сучасна наука в галузі пакування та підготовка кадрів вищого рівня. Достатньо зазначити, що кожного року близько 250 фахівців поповнюють лави українських пакувальників.

Тема розробки активних та «розумних» пакувань із використанням сучасних технологій, зокрема із використанням нанорозробок, вже не один рік досліджується д.х.н. із КПП, проф. **Валентином Шерстюком**. І хоча сьогодні ці розробки навіть в уявленні пакувальних корифеїв мають занадто оптимістичний вигляд, у світі все частіше та гучніше лунають схвальні вигуки на їх практичне застосування.





Валентин Шерстюк та його колеги представили результати своїх останніх досліджень друкарських процесів та визначили їхній вплив на характеристики нанофотонних покриттів.

Як завжди, професор не зміг оминати сучасні події в українському суспільстві, навівши думки російського історика, доктора філософських наук Ігоря Чубайса про те, що дії Росії щодо України — це велика помилка, за яку мусять відповідати майбутні покоління Росії.

Наступним доповідачем був експерт відділу сприяння торгівлі та інвестиціям Посольства Республіки Польща в Україні пан **Бартош Фурман** із доповіддю «Виробництво та ринок упаковки в Польщі». Поряд з відчутними здобутками пакувальної індустрії Польщі, яка досягла 1,4 % світового ринку пакування, польські підприємства 20 % своєї продукції експортують в інші країни. Саме через це особливо цікавим є досвід польських пакувальників, якому в доповіді Бартоша Фурмана була приділена особлива увага. На думку присутніх, і досвід Польщі, і особливо доброзичливі стосунки між Україною та Польщею, а також запропонована допомога від Посольства Польщі в Україні нададуть новий поштовх для реалізації потенційних експортних можливостей українських пакувальників.

Доповідь «Основи методології створення пакувальних машин із мехатронних модулів», яку зробив к.т.н. **Микола Якимчук** у співавторстві з проф. Олександром Гаввою, розкрила сучасні уявлення та підходи до реалізації новітніх технологій в пакувальному обладнанні завдяки підвищенню його технічного рівня, продуктивності, універсальності та

гнучкості до переналаджування. Переходячи від обладнання 4 покоління до обладнання наступних поколінь — 5 і 6, треба відмітити, що на черзі обладнання, побудоване на елементах штучного інтелекту. В доповіді детально подано результати досліджень та міркування про новітні пакувальні машини та потокові лінії, як інтегральні технічні комплекси, створені на базі мехатронних функціональних модулів із великою кількістю синергетично пов'язаних між собою характеристик та параметрів.

К.т.н. **Вероніка Халайджі** свою доповідь «Як знайти партнера в пакувальній індустрії України» присвятила новому проекту ІАЦ «Упаковка» — інформаційно-пошуковій системі raskinfo.com.ua. Виходячи з сучасних вимог якнайшвидше та найдостовірніше знайти конкретного виробника пакувальної продукції у сучасному океані продуцентів навіть локального українського ринку, розробники пропонують проект з кількома алгоритмами такого пошуку — за назвою компанії, видом упаковки, упакованою продукцією, обладнанням, алфавітним покажчиком з малюнками пакувань та за послугами в галузі пакування. Такий пошук — професійний, доступний, простий, зрозумілий та швидкий.

Вже стало традицією наприкінці пленарного засідання спостерігати виступ **Володимира Слабого**. Цього разу його доповідь «Законодавство України про упаковку (нинішня ситуація)» була більш ніж актуальна, бо проект чергового Закону України «Про упаковку та відходи упаковки» знаходиться у Верховній Раді, а він є тим ключем, який відкриває шлях до створення в Україні сучасної системи



поводження з відходами упаковки, адаптованої до норм та правил відповідної Європейської директиви. Ще раз були продемонстровані сучасні аспекти створення таких систем у 27 країнах ЄС, наведені дані про результати їх впровадження, визначені основні завдання для реалізації цих підходів в Україні.

На цьому пленарне засідання було завершено і саме час підійти до наступного секційного, але спочатку хочеться зупинитись на дружній зустрічі учасників конференції ввечері першого дня. Тим паче, що ця зустріч була присвячена випуску 100-го номеру журналу «Упаковка». Цей номер вийшов 1 червня 2014 р., якраз напередодні конференції, яка мала відбутися в Алушті. Але святкування перенесли на осінь, на Алуштинську конференцію у Пущі-Водиці.

Окрім привітань та подарунків, які цього вечора отримали видавці часопису «Упаковка», варто нагадати і про деякі здобутки редакції, редакційного та авторського колективу журналу. **100 номерів журналу — це:**

- 7856 сторінок та 2152 статті;
- 897 авторів, з яких 64 доктори, 136 кандидати наук;
- 82 автори з 15 країн світу;
- співробітництво з 905 компаніями світу;
- 76 видань з пакування, загальним накладом 63,6 тис. примірників;
- 16 конкурсів, 2533 зразки упаковки;
- 32 конференції, 573 доповіді та 2838 учасників.

Учасники цієї зустрічі, які майже всі мають безпосереднє відношення до підготовки та випуску журналу «Упаковка», відчували, що всі вони — одна єдина сім'я, у якої ще все попереду. Наступного дня відбулось секційне засідання конференції, на якому, на відміну від конференцій минулих років, слово було надано представникам компаній. Усі вони присвятили свої доповіді сучасним розробкам технологій, матеріалів, обладнання, більшість з яких були інноваційними.

Заслужують на увагу матеріали доповіді **Олександра Козлова** із компанії «Дюпон Україна» «Тенденції у виробництві полімерних плівок екструзією з видувом», зокрема про новітню технологію Triple Bubble; к.х.н. **Сергія Петренка** з компанії «Техноком» про переваги та недоліки наповнених полімерних матеріалів; **Олександра Бенчука** з PackGroup про інновації та тенденції виробництва сучасної полімерної упаковки; проф. **Івана Регея** з УАД про обґрунтування вибору раціональних геометричних параметрів споживчої упаковки; **Олени Микитенко** з Markets

Consulting Group про ринок склотари та комбінованої упаковки в Україні.

Особливо треба відзначити доповіді:

- **Дмитра Толстолужського** з компанії Hewlett Packard, який повідав усім присутнім про потужну ходу сучасних технологій цифрового друку упаковки та етикетки, які розробляє та впроваджує всесвітній лідер з цифрового друку компанія Hewlett Packard;
- **Андрія Беспалова** з компанії Festo про інноваційні рішення для пакувального обладнання — зокрема про маніпулятор для укладання корексів, трипод ЕХРТ для укладання штучних виробів та Н-портал ЕХСМ;
- **Катерини Мазуренко** з Ветропак Гостомельського Склозаводу про три кити сталого розвитку. Напрочуд вдале пояснення сучасної концепції розвитку компанії, яка передбачає мислення та діяльність фахівців підприємства за принципами сталого розвитку у всіх його аспектах — економічному, соціальному та екологічному.

До речі, деяким доповідачам запропоновано підготувати статті для журналу «Упаковка» за визначеними напрямами їх доповідей.

(Для тих, хто не зміг відвідати конференцію, повідомляємо, що замовити матеріали конференції «Пакувальна індустрія (ринок, інновації, бізнес-практики)» можна за адресою: 02660, МСП-660, Україна, м. Київ, вул. М. Раскової, 11, ІАЦ «Упаковка», тел/факс: (044) 517-23-83, 517-23-23, 517-22-55, upakjour@nbi.com.ua; upakjour@ukr.net).

Після конференції

Доповіді зроблені, питання задані, відповіді отримані. Завершилась ще одна чергова професійна зустріч українських пакувальників. Цього разу у Пущі-Водиці. Всі учасники отримали комплект матеріалів, а найголовніше, нові знання, нову інформацію про стан та перспективи розвитку пакування. Проглянувши анкети, які заповнили учасники конференції, можна сказати, що конференція «Пакувальна індустрія» зробила ще один інформаційний крок. Крок, який принесе нові здобутки у вигляді нових підприємств, модернізованих потужностей, нових інноваційних технологій для виробництва пакувальних матеріалів, упаковки та обладнання.

До зустрічі на ІХ Алуштинській конференції! Де? Давайте зачекаємо... *Ж*

Валерій Кривошей, к.х.н.